

国家发展和改革委员会办公厅 文件 工业和信息化部办公厅

发改办高技〔2014〕1717号

国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅 关于印发2014年度集成电路产业研究与开发 专项资金申报指南的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市发展改革委、工业和信息化主管部门：

为做好集成电路产业研究与开发专项资金申报工作，依据财政部、原信息产业部、国家发展改革委《关于印发〈集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法〉的通知》（财建〔2005〕132号），我们制定了《2014年度集成电路产业研究与开发专项资金申报指南》，现印发你们，请抓紧组织申报工作。

附件:2014年度集成电路产业研究与开发专项资金申报指南



附件

2014 年度集成电路产业研究与开发专项资金申报指南

一、芯片设计

- (一) 高性能处理器芯片设计
- (二) 存储器及存储控制芯片设计
- (三) 模拟及数模混合芯片设计
- (四) 计算机、通信网络及终端设备核心芯片设计
- (五) 移动智能终端核心芯片设计
- (六) 可穿戴智能终端核心芯片设计
- (七) 物联网(传感网)、云计算专用芯片设计
- (八) 智能电视及数字多媒体核心芯片设计
- (九) IC 卡、电子标签及读写机具用芯片
- (十) 电源管理、平板显示专用芯片设计
- (十一) 信息安全核心芯片设计
- (十二) 机电仪器设备、汽车电子及医疗设备专用芯片设计
- (十三) 节能环保产品芯片设计
- (十四) 工控/数控装置核心芯片设计
- (十五) EDA 工具及 IP 核设计

二、芯片制造

- (一) 集成电路先进制造工艺研发和产业化

(二) 集成电路特色制造工艺研发和产业化

(三) 砷化镓、锗硅、碳化硅等集成电路工艺研发和产业化

三、芯片封装和测试

(一) 新型封装技术、工艺及产品研发和产业化

(二) 新型封装材料研发和产业化

(三) 高速测试技术研发及实用化

四、集成电路专用装备及关键材料

(一) 光刻机、刻蚀机、清洗机等集成电路关键专用设备研发和产业化

(二) 集成电路用硅片等关键材料技术研发和产业化